

<<计算机应用基础>>

图书基本信息

书名：<<计算机应用基础>>

13位ISBN编号：9787122064547

10位ISBN编号：7122064549

出版时间：2009-8

出版时间：化学工业出版社

作者：赵美惠 编

页数：287

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<计算机应用基础>>

### 前言

本书为配合教育部“信息技术及应用培训”的教育工程（简称“IT&AT”教育工程）而编写，重点介绍了目前使用最广泛的微软Office系列软件的基本功能与使用方法，用实例引导，在练习过程中掌握，具有很强的实用性。

本着以素质教育为核心、以培养就业上岗能力为重点，以技能训练为特色的指导思想，书中的内容覆盖了计算机的基础理论、网络知识以及Word、Excel、PowerPoint、FrontPage等软件的应用，既强调了知识的渐进性、系统性，又兼顾了知识的适用性和实用性。

本书共9章，内容丰富，结构清晰明了，语言通俗易懂，具有较强的可读性，同时，本书还配备技能操作训练素材库，能指导学生在学中练、练中学，从而提高分析和解决问题的实际能力，体现了高职高专教材的职业性和实践性。

按照本书所讲内容进行学习，读者可以轻松地掌握微软Office系列软件的应用技能和计算机基础知识。

本书可作为高职高专院校和中等职业学校计算机基础课教材，同时也适合作为相关培训班的教材。

本书由赵美惠任主编。

参编人员有周胜、孙越、曹越、陆启军、石艳红等，全书由张祖鹰主审。

本书在编写过程中参考了相关图书、资料，在此对这些图书、资料的作者表示感谢。

由于编者水平有限，书中难免有不妥之处，敬请读者予以批评指正。

## <<计算机应用基础>>

### 内容概要

《计算机应用基础》为配合教育部“信息技术及应用培训”的教育工程（简称“IT&AT”教育工程）而编写。

重点介绍了目前使用最广泛的微软Office系列软件的基本功能与使用方法，用实例引导，在练习过程中掌握，具有很强的实用性。

《计算机应用基础》内容包括计算机的基础理论，网络知识以及Word、Excel、PowerPoint、FrontPage等软件的应用知识。

《计算机应用基础》分为9章，内容丰富，结构清晰明了、语言通俗易懂，具有较强的可读性。同时配备技能操作素材库，按照《计算机应用基础》所讲内容进行学习，读者可以轻松地掌握微软Office系列软件的应用技能和计算机基础知识。

《计算机应用基础》可作为高职高专院校计算机应用技术课程教材，也可作为成人教育、职业技能培训的教材，同时还可以作为广大IT爱好者个人工作、学习的自学参考书使用。

## <<计算机应用基础>>

### 书籍目录

第1章 信息技术概述1.1 信息技术1.2 微电子技术1.3 电子数字技术基础本章小结习题第2章 计算机的组成原理2.1 计算机的组成及分类2.2 主机的构成2.3 常用输入设备本章小结习题第3章 计算机网络技术3.1 计算机网络概念3.2 局域网3.3 广域网3.4 因特网3.5 因特网的服务3.6 计算机网络实验本章小结习题第4章 操作系统4.1 操作系统概述4.2 Windows操作系统4.3 基本操作4.4 操作系统实验本章小结第5章 文字处理Word软件应用5.1 Word基本知识5.2 Word文档的操作5.3 Word操作实验第6章 电子表格Excel软件应用6.1 Excel基本知识6.2 Excel的基本操作6.3 Excel操作实验第7章 演示文稿PowerPoint软件应用7.1 PowerPoint基本知识7.2 演示文稿的基本操作7.3 PowerPoint2000操作实验第8章 网页制作FrontPage软件应用8.1 FrontPage基本知识8.2 FrontPage2000的基本操作8.3 FrontPage2000操作实验第9章 综合实验9.1 概述9.2 综合实验一Word和Excel的基本操作（一）9.3 综合实验二Word和Excel的基本操作（二）9.4 综合实验三FrontPage和PowerPoint的基本操作（一）9.5 综合实验四FrontPage和PowerPoint的基本操作（二）参考文献

## &lt;&lt;计算机应用基础&gt;&gt;

## 章节摘录

1.2 微电子技术 1.2.5 集成电路的制造过程 集成电路是在硅衬底上制作而成的。硅衬底是将单晶硅经切割、研磨和抛光后制成的像镜面一样光滑的圆形薄片。它的厚度不足1mm，其直径可以是6英寸、8英寸、12英寸甚至更大，这种硅片称为硅抛光片。硅抛光片经过严格清洗后即可直接用于集成电路的制备。

制备集成电路所用的工艺技术称为硅平面工艺，它包括氧化、光刻、掺杂和互连等多项工序。把这些工序反复交叉使用，最终在硅片上制成包含多层电路及电子元件（如晶体管、电阻、电容、逻辑开关等）的集成电路。

视硅片大小和集成电路的复杂程度，每一硅抛光片上可制作出成百上千个独立的集成电路，这种整齐排满了集成电路的硅片称作“晶圆”。

晶圆制成后，用集成电路检测仪对每一个独立的集成电路逐个进行检测，将不合格的集成电路用磁浆点上记号。

然后将晶圆切开，分割成一个个单独的集成电路小片，通过电磁法把点了磁浆的废品剔除，将合格的集成电路按其电气特性进行分类。

这些集成电路小片就称为芯片（chip）。

因为晶圆上布满了这种芯片，所以也有人把晶圆称为大圆芯片或者直称其为芯片。

将每个芯片固定在塑胶或陶瓷的基座上，并把芯片上蚀刻出来的引线与其基座底部伸出的插脚进行连接，然后盖上盖板进行封焊，以保护芯片免受机械刮伤或环境污染。

常见的集成电路制造的最后一道工序是成品测试。

经测试后按照它们的性能参数分为不同等级。

<<计算机应用基础>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>